

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002年1月17日 (17.01.2002)

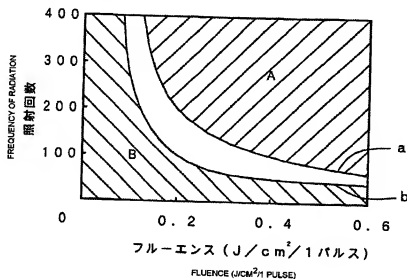
PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/04705 A1

- (51) 国際特許分類: C23C 18/20
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/04491
- (22) 国際出願日: 2000年7月6日 (06.07.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立行政法人産業技術総合研究所 (NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒100-8921 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 Tokyo (JP). オムロン株式会社 (OMRON CORPORATION) [JP/JP]; 〒600-8530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中宏和 (TANAKA, Hirokazu) [JP/JP]. 廣野 聡 (HIRONO, Satoshi) [JP/JP]; 〒600-8530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 青山 蓓, 外 (AOYAMA, Tamotsu et al.); 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル 青山特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR PRELIMINARY TREATMENT OF MATERIAL TO BE SUBJECTED TO ELECTROLESS PLATING

(54) 発明の名称: 無電解めっきの前処理方法



(57) Abstract: A method for the preliminary treatment of a material to be subjected to electroless plating, characterized in that a polymer material is mixed with an inorganic filler, a formed product obtained from the resultant mixture is immersed in an anionic aqueous solution containing a noble metal. A formed product having been immersed as mentioned above is then subjected to electroless plating.

ABSTRACT

An inorganic filler is added to a polymeric material.
An obtained polymeric mold is irradiated with a laser and
immersed in a noble metal aqueous solution and thereafter
5 electroless plating is performed.

10070292-030502